

「반도체 FOWLP 소부장 테스트베드 구축」 기업지원 프로그램 공고

충남테크노파크는 반도체 첨단 패키징 분야 기반조성을 위한 「FOWLP 소부장 테스트베드 구축」 사업을 추진하고 있습니다. 이에 따라, 반도체 기업의 기술개발 및 사업화를 지원하는 기업지원 프로그램 수요기업 및 컨설팅 전문기업을 모집하고자 아래와 같이 공고하오니 많은 참여 바랍니다.

2026년 7월 20일
한국광기술원장
한국전자기술연구원장
충남테크노파크원장

1. 지원사업 개요

- (사업명) FOWLP 소부장 테스트베드 구축
- (지원기관) 한국광기술원, 한국전자기술연구원, 충남테크노파크
- (지원내용) FOWLP 산업 기술·사업화 맞춤형 지원

※ FOWLP(Fan-out Wafer Level Packaging): 반도체 칩을 기판 없이 웨이퍼 수준에서 재배선층(RDL)으로 외부 입출력 단자를 확장해 고성능 패키지를 구현하는 첨단 반도체 후공정 패키징 기술

- (지원대상) 지역제한 없음
 - FOWLP 및 첨단 패키징 기술 적용·고도화 희망 기업
 - 반도체 후공정·첨단 패키징 분야로의 사업 진입을 희망하는 기업
- (지원기간) 2026. 9. ~ 2026. 11.(약3개월)
- (접수기간)
 - Track ① : 2026. 8. 14.(금) 18:00까지
 - Track ② : 상시모집
- (신청방법) Track에 따라 신청 및 지원 방법 상이함으로 확인 필요

2. 지원내용

Track 1 기술·사업화 컨설팅

□ 지원분야

○ (지원내용)

구 분	지원 분야	지원기관	지원내용	최대 지원액
기술·제품 사업화	PoC/PoM 컨설팅	충남테크노파크	- PoC/PoM 전문가 매칭 지원 - 보유 기술의 FOWLP 공정 실증 가능성 및 적합성 검토 - 기술 개선방향 도출 등	기업당 최대 8,000천원

* 기업부담금 : 지원금 초과 금액 + 부가세

○ (지원방식)

- 신청기업이 희망하는 외부 컨설팅 전문기업을 직접 지정하여 수행하여야하며, 기업 전문성 등 적정성을 평가위원회에서 확인하고 확정함
- 기업의 공급기업(컨설팅 전문기업)은 1개 이상일 수 있음
- 제출/신청한 수요서에 따라 컨설팅 전문기업이 지원금액 도출하며 선정 심의를 통해 지원금액이 조정될 수 있음
- ‘충남TP - 신청기업 - 컨설팅 전문기업’ 간 3자 협약 추진

□ 신청서 접수

- (신청방법) 방문접수 또는 전자메일 접수
- (신청·접수처/문의처)

수행기관	담당자	연락처	이메일	주소
(재)충남테크노파크	이명윤	041-901-9011	mylee@ctp.or.kr	충청남도 아산시 음봉면 연암산로 88, 사무동 215호

- (신청양식) 참여기업 신청서 등 제출서류는 첨부된 별지 서식 참조

구분	제출서류	서식	비고
기술·제품 사업화	FOWLP 기업 기술·사업화 맞춤형 지원사업 신청서	서식 1	필수
	FOWLP 기업 기술·사업화 맞춤형 지원사업 수행계획서 (기업)	서식 2	필수
	정보활용동의서	서식 3	필수
	참여의사 확인·개인정보 활용동의서	서식 4	필수
	사업자등록증	-	필수

□ 평가선정

○ (선정방법)

- (1차) 제출서류 및 지원조건 검토
- (2차) 평가위원회는 평가항목 의거 외부전문가를 통한 평가 진행

○ (평가기준(안))

평가항목		세부내용	배점
실증·사업화 가능성 (선택)	기술성	기술의 차별성, FOWLP 적용 타당성, 해결 필요성 등	50
	사업성	목표시장 적정성, 고객 문제 적합성, 사업화 파급효과	
지원적합성		외부 전문가 지원 필요성, 컨설팅 개입 효과, 검증 가능성	20
수행역량		기업 의지, 후속 추진 가능성, 내부 대응 체계 등	20
기대효과		후속 R&D/실증/투자/판로 등 연계 가능성	10
합 계			100

※ PoC(기술성)+PoM(사업성) 경우, 각각 25점 배점으로 함

※ 상기 지표는 변경될 수 있음

□ 추진일정

○ 참여기업 선정절차 및 일정(안)

사업공고	⇒	신청서 접수	⇒	심의 선정	⇒	컨설팅 수행	⇒	평가 위원회	⇒	지원금 지급
참여기관 홈페이지 외		기업 ↓ 충남TP		적정성 평가위원회		전문가 ↓ 기업		최종 평가위원회		충남TP ↓ 전문가
7.20.(월)		~8.14.(금)		8월 3주		~11월		~ 12월 초		~ 12월

※ 상기 일정은 추진 상황에 따라 변동될 수 있음

□ 지원분야

○ (지원내용)

구 분	지원 분야	지원기관	지원내용
기술 서비스	① 시험·평가	한국전자기술연구원	- 구축 인프라(시설장비**/SW/전문인력) 활용 시험 및 평가 지원
	② 기술지도	한국광기술원	- 구축 인프라(시설장비**/SW/전문인력) 활용 기술지도 • FOWLP 및 첨단패키징 공정·소재·부품 관련 기술 자문 및 공정 적용성 검토 • 공정 최적화, 성능 개선 및 품질 향상을 위한 기술 컨설팅 지원 • 시설·장비 및 전문인력 연계를 통한 기술 고도화 지원
	③ 애로기술 지원	한국광기술원	- 구축 인프라(시설장비**/SW/전문인력) 활용 애로기술 지원 • FOWLP 및 첨단패키징 공정 불량, 수율 저하, 신뢰성 저하 등 기술 애로사항 분석 및 원인 진단 • 문제 해결을 위한 공정 개선 및 맞춤형 기술지원 제공 • 시설·장비 및 전문인력 연계를 통한 문제 해결 및 애로기술 지원

* 비용의 경우, 해당 기관 담당자와 상의 필요

** 구축 장비 : 붙임파일 참조

- 한국광기술원 <https://www.kopti.re.kr/sp/index.do>

- 한국전자기술연구원 <https://keti.re.kr/reliability/main/main.php>

○ (지원방식) 전문가/전문기관 매칭 방식 수행

① 시험·평가

- 수행주체 직접 지원
- 한국전자기술연구원 담당자 의뢰 및 기관 지정 시험의뢰서 제출

② 기술지도 및 애로기술 지원

- 수행주체 직접 지원
- 한국광기술원 담당자 의뢰 및 기관 지정 신청서 제출

□ 신청서 접수

- (신청방법) 담당자 문의 후 신청
- (신청·접수처/문의처)

수행기관	담당자	연락처	이메일	주소
한국전자기술연구원	김*민	010-2*98-3*6*	jemini@keti.re.kr	경기도 성남시 분당구 새나리로 25
한국광기술원	우*찬	010-5*30-8*9*	kichan@kopti.re.kr	전남광주통합특별시 북구 첨단벤처로 108번길 9

□ 추진일정

- 상시 수행으로 상시 모집

3. 유의사항

- (신청제외 대상) 다음 사항에 모두 해당하지 않는 기업

구 분	신청제외 대상	
공통	1	· 휴·폐업 중인 기업
	2	· 국세 또는 지방세를 체납 중인 자 또는 기업
	3	· 한국신용정보원의 「일반신용정보관리규약」에 따라 연체, 대위변제·대지급, 부도, 관련인, 금융질서문란, 회생·파산 등의 정보가 등록되어 있는 기업
	4	· 「민사집행법」에 따라 채무불이행자명부에 등재되거나, 신용정보집중기관(은행연합회 등) 또는 금융기관에 의해 채무불이행자(체불사업자 포함)로 등록되거나 불량거래처로 규제 중인 기업
	5	· 임직원의 횡령·배임 등 사회적 물의를 일으키거나, 그 밖의 허위 및 부정한 방법(제3자 부당개입 등)으로 신청한 자 또는 기업
개별	6	· 의무사항(보고서/성과실적 제출, 정산금/환수금 납부 등)을 불이행하거나, 각종 법령 위반(사업비 목적 외 사용 등)으로 국가연구개발사업, 정부지원사업, 지역산업육성사업 등에서 제재 중인 기업 (선택한 지원사업에 한함)
	7	· 그 외 지원사업별 지원제외 대상에 해당하는 기업 (선택한 지원사업에 한함)

- (기타사항)

- 제출된 서류는 일절 반환하지 않음
- 본 지원사업의 경우, 지원예산 초과 시 조기 종료될 수 있음
- 지원 종료 후 성과관리와 만족도 파악을 위한 조사 및 성과 제출 필수